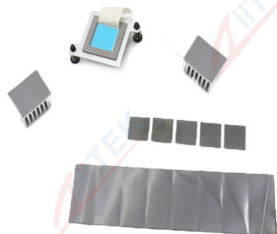


TIC[®] 800G 为高可靠性、高导热性能的导热相变化材料。它在常温下为固态，便于操作和安装；当达到特定相变温度时，材料会软化并呈半流动状，充分填充发热界面与散热器之间的微观空隙，显著降低接触热阻，实现良好的热传递效率。该材料能解决中高功率密度电子器件在瞬态或稳态工作下的散热问题。



特性

- 》高的热传导率
- 》表面较柔软
- 》低热阻
- 》自带粘性，无需额外胶粘剂

应用

- 》功率转换设备
- 》智能手机主芯片
- 》视听产品
- 》荷载处理器

TIC[®] 800G 系列特性表

产品名称	TIC [®] 804G	TIC [®] 805G	TIC [®] 806G	TIC [®] 808G	TIC [®] 810G	TIC [®] 812G	测试方法
颜色	灰色						目测
厚度 (inch/mm)	0.004 0.10	0.005 0.13	0.006 0.15	0.008 0.20	0.010 0.25	0.012 0.30	ASTM D374
密度 (g/cm ³)	2.3						ASTM D792
相变温度 (°C)	50~60						ZKTM J052
建议使用温度范围 (°C)	-40~125						ZKTM J025
介电常数 @1MHz	4.9						ASTM D150
导热系数 (W/m·K)	5.0						ASTM D5470
	5.0						ISO22007
热阻抗 (°C·in ² /W) @50psi	0.028	0.031	0.032	0.049	0.064	0.078	ASTM D5470
阻燃等级	V-0						UL 94

产品规格

标准厚度: 0.004" (0.10 mm) , 0.005" (0.13 mm) ,
0.006" (0.15 mm) , 0.008" (0.20 mm) ,
0.010" (0.25 mm) , 0.012" (0.30 mm)

标准尺寸: 11.811" × 19.685" (300 mm × 500 mm)

压敏黏合剂: 不适用于TIC[®] 系列产品。

TIC[®]系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

热阻抗

